

2017年12月期
第3四半期
決算説明資料

株式会社RS Technologies
東証1部：3445

注意事項

- 当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性がございます。
- 本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実性を含んでおります。
- 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。
- 資料中で「生産能力」についての記載は、全て当社グループの“300mm再生ウェーハ”の能力を指しております。

目次

2017年12月期第3四半期決算情報 及び期末配当政策	P. 4- 7
中・長期的な経営方針	P. 8-13
会社紹介	P.14-24

2017年12月期第3四半期 決算情報 及び期末配当政策

2017年12月期第3四半期累計決算情報 ☆ サマリー ☆

半導体市場の好調に伴い、ウェーハ需要が増加したことから、再生ウェーハ市場も良好な需給環境が継続し、当社第3四半期決算も好調に推移。

単位：百万円

	2017年12月期 第3四半期累計	2016年12月期 第3四半期累計	前期比	2017年12月期 修正事業計画 (2017年1~12月) 2017/8/3発表	進捗率
売上高	7,874	6,271	125.5%	9,450	83.3%
営業利益	2,069	890	232.5%	2,550	81.1%
営業利益率	26.3%	14.2%	+12.1pt	27.0%	-
経常利益	2,251	491	458.5%	2,650	84.9%
経常利益率	28.6%	7.8%	+20.8pt	28.0%	-
四半期純利益	1,501	242	-	1,630	92.1%

2017年12月期第3四半期決算情報 ☆ 前年同期比 ☆

台湾子会社の稼働率が上昇したことに伴い、前年同期に比べ、売り上げは20%以上、営業利益は70%以上増加。

単位：百万円

	2017年12月期 第3四半期	2016年12月期 第3四半期	差額	前年同期比
売上高	2,903	2,394	+509	121.2%
営業利益	665	384	+281	173.2%
営業利益率	22.9%	16.0%	+6.9pt	-
経常利益	653	335	+318	194.9%
経常利益率	22.5%	14.0%	+8.5pt	-
四半期純利益	432	177	+255	244.0%

期末配当政策

	2017/12 (計画)
配 当 金	普通配当 5円
株 主 優 待	クオカード 3,000円

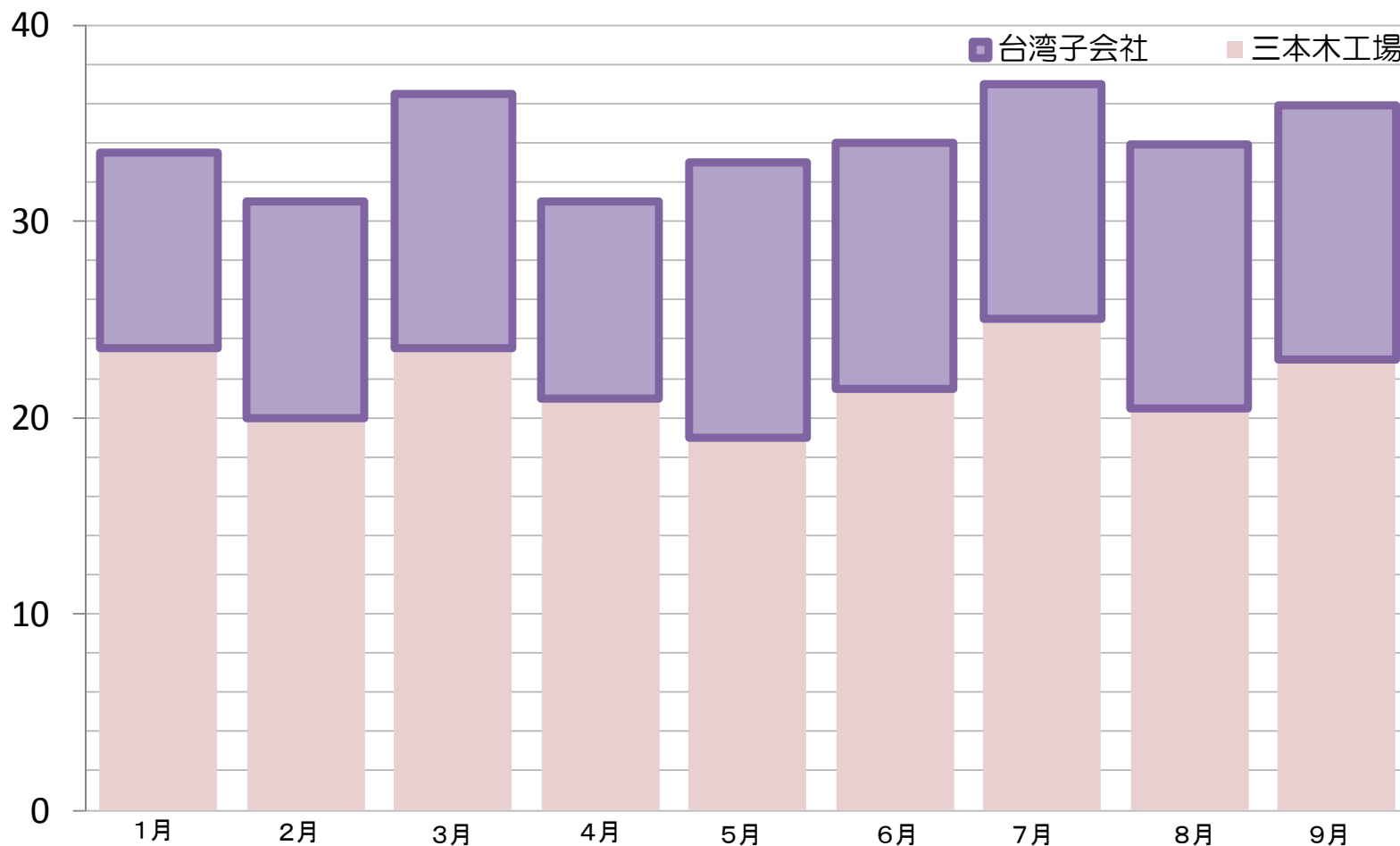
中・長期的な経営方針

中・長期的な経営方針

- ①台湾子会社・三本木工場の生産力拡大
- ②再生市場での当社のシェア拡大
- ③伸長する需要の取込み
- ④潜在的な再生市場の開拓
- ⑤中国半導体マーケットへの参入

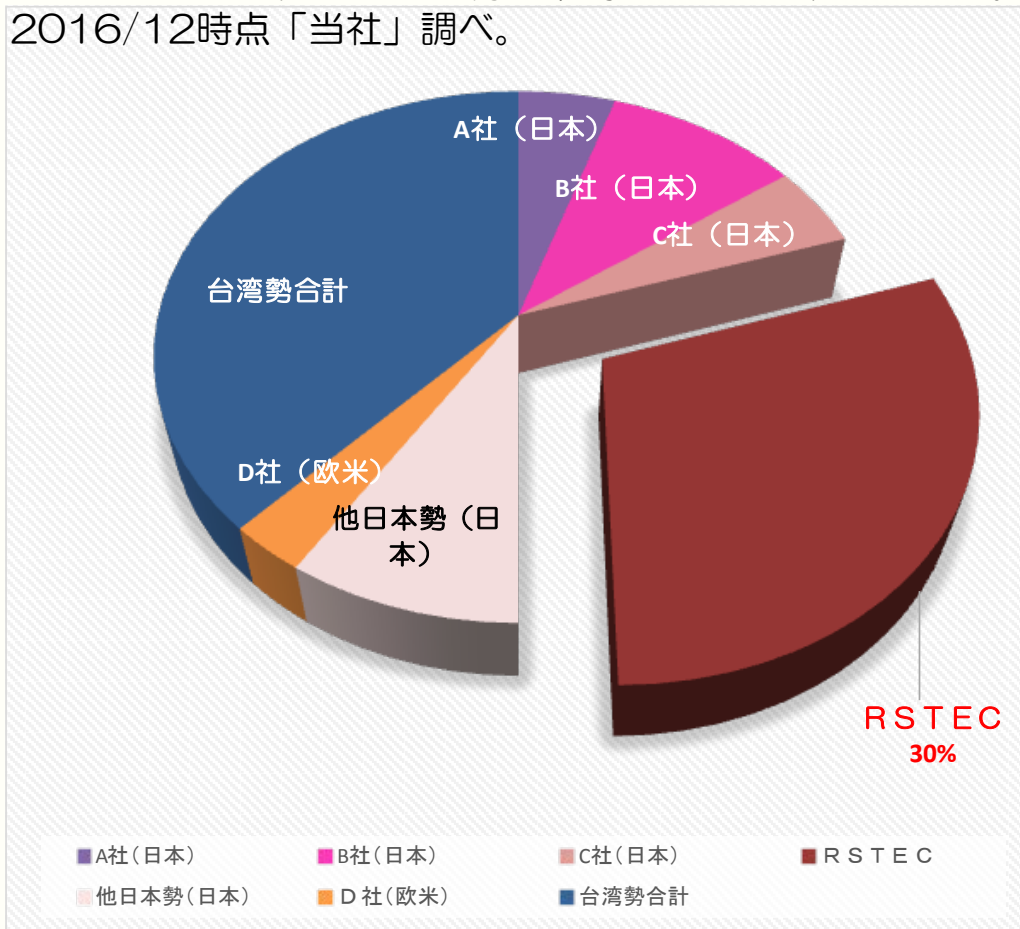
① 「三本木工場と台湾子会社の出荷推移」

万枚 ～三本木工場と台湾子会社の300mmウェーハ出荷枚数推移～



② 「再生市場での当社のシェア拡大」

下図のシェアは、300mm再生市場における当社のシェア。
2016/12時点「当社」調べ。



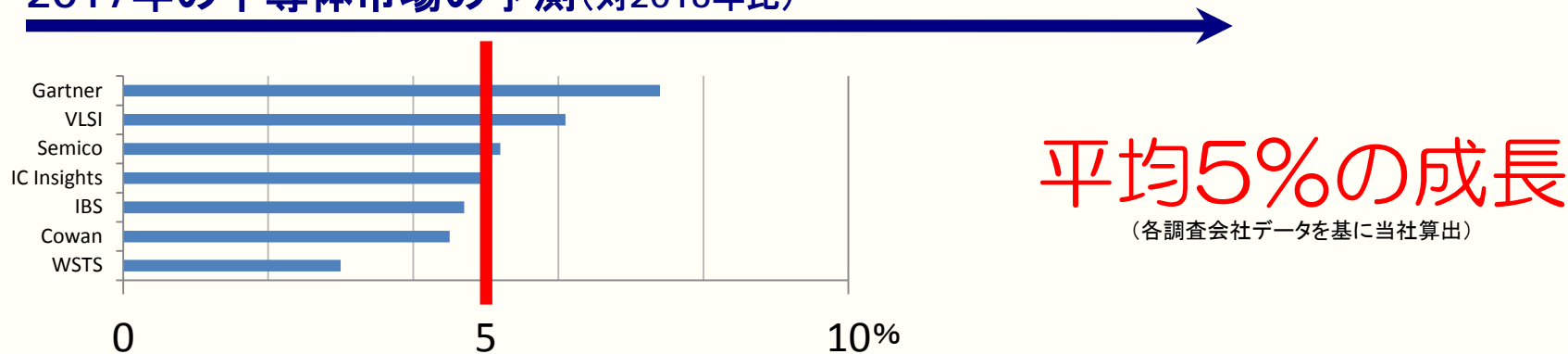
台湾の新設・三本木の増設により、生産能力が増加、現在のシェアは30%に上昇。

両工場の既存設備によるさらなる生産力のアップ、三本木の空工場利用、業務提携・M&A等の手法を用いて

2018年に40%
にシェアを拡大
目指す

③ 「伸長する需要の取込み」

2017年の半導体市場の予測(対2016年比)



2017年のNAND・ファンドリーの新規設備投資予測(2016年との比較)



2017年の新品ウェーハ単価予測(対2016年比)

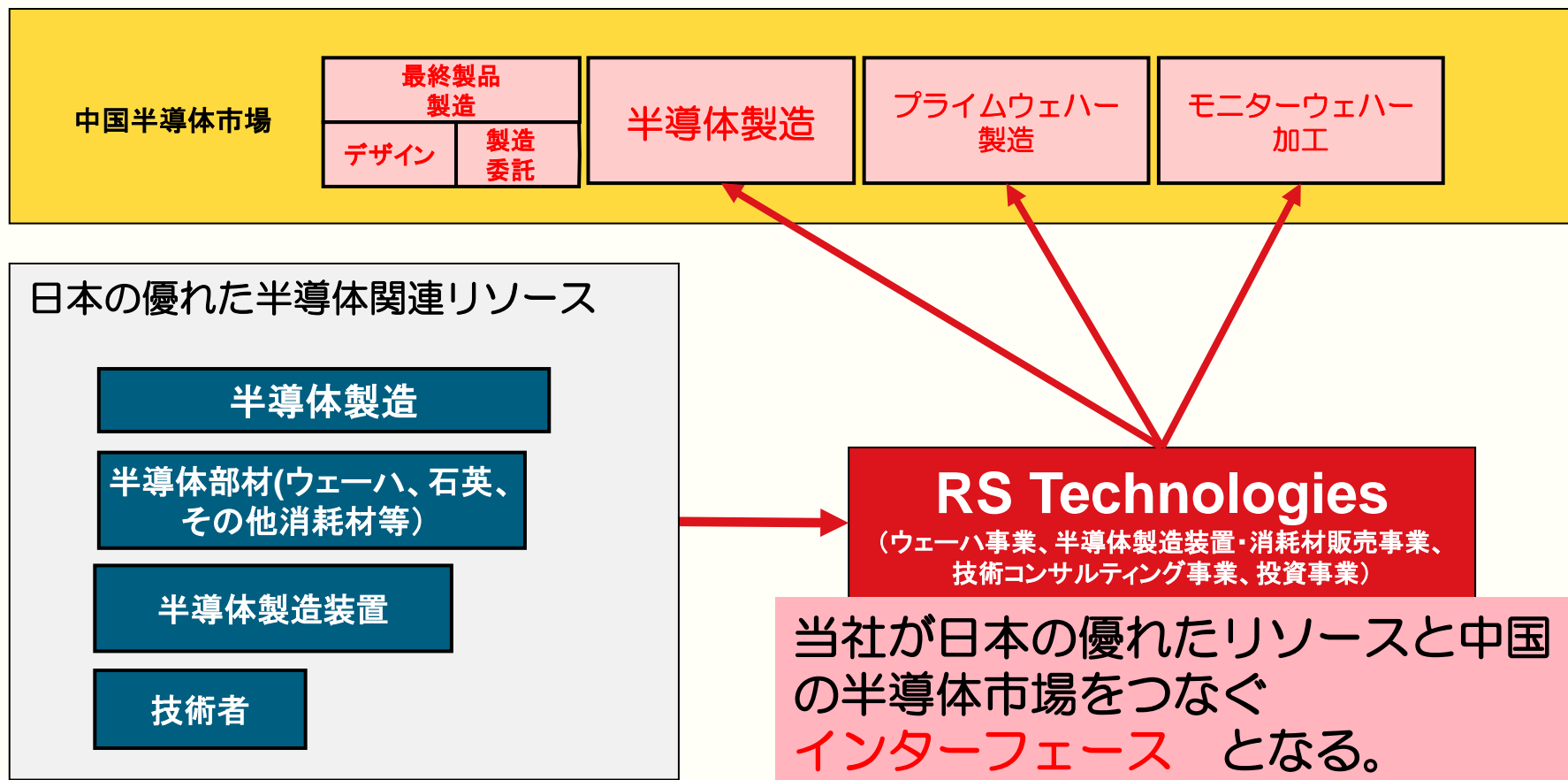
平均15%増の単価
(報道、業界調査より当社算出)

再生ウェーハ市場も需要増加が見込まれる。

⑤ 「中国半導体マーケットへの参入」

中国は2020年までに半導体産業に5兆円の投資を計画。内製化のために、国内企業の育成と海外メーカーのM&Aを促進。

当社は、設立以来構築してきた中国半導体企業との関係をさらに強化。中国市場に参入。



会社紹介

会社概要

社名	株式会社 RS Technologies
本社	東京都品川区大井1-47-1 NTビル 12F
三本木工場	宮城県大崎市三本木音無字山崎26-2
台南工場	No.1 Nanke 7th Rd., Southern Taiwan Science Park, Tainan City 74144 Taiwan
経営理念	「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、 常に創造し挑戦する。」
資本金	64,185万円（2017年9月30日時点）
取締役	方永義、本郷邦夫、鈴木正行、近藤淳行、遠藤智 石黒正亨、李宗根、渡邊泰紀、内海忠
設立	2010年12月10日
操業開始	2011年1月1日
事業内容	半導体用シリコンウェーハの再生、加工、販売、 ソーラー売電、 半導体製造設備・半導体部材（ターゲット材）販売

三本木工場

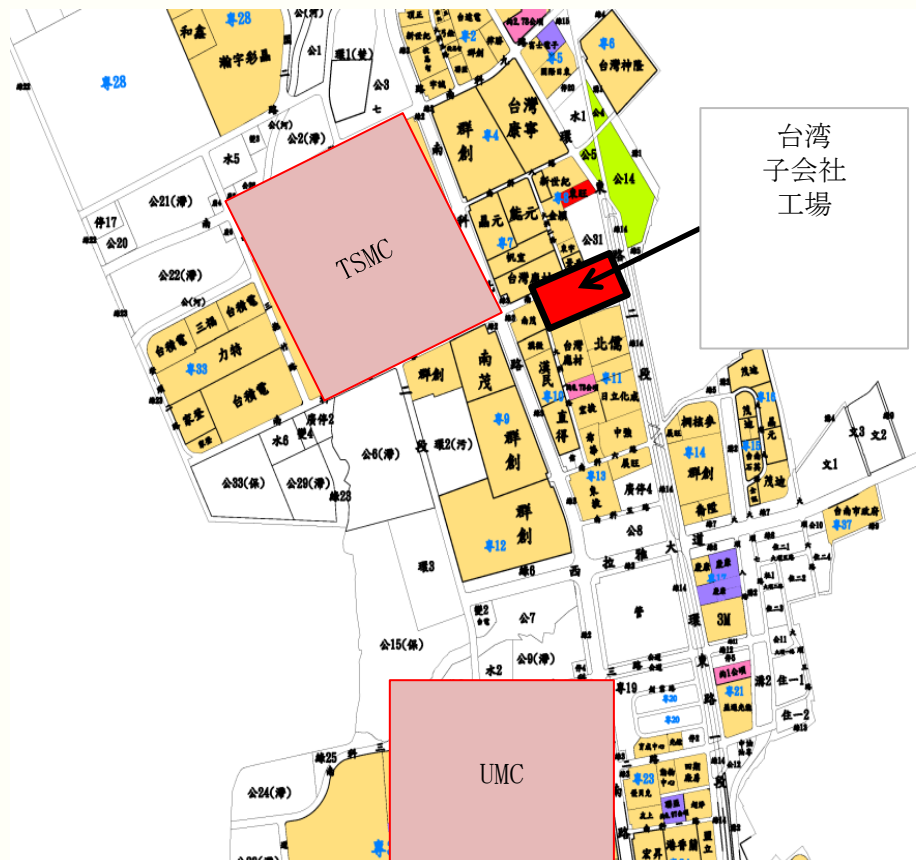


台南工場

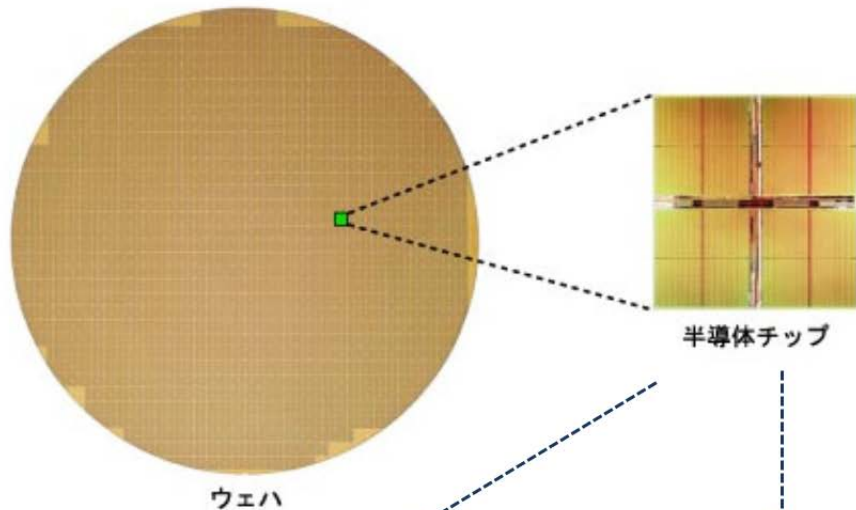
工場の外観



台南サイエンスパーク内地図

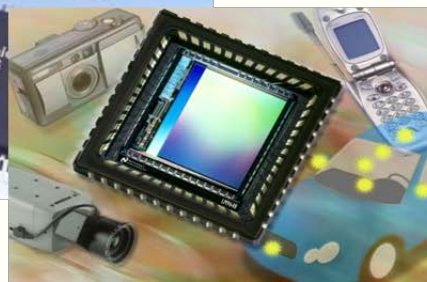
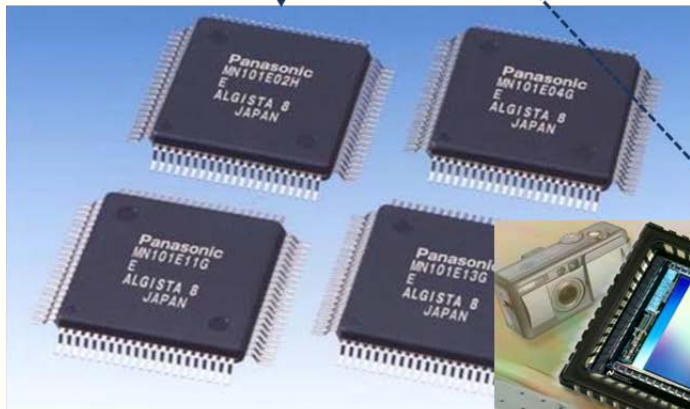
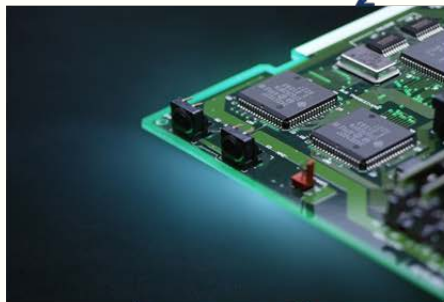


シリコンウェーハ再生事業-半導体とウェーハ

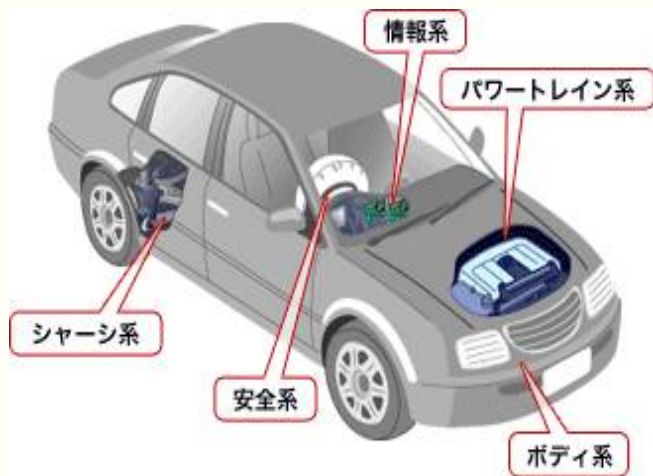


各種電気製品や自動車等の基幹部品となる半導体は円盤状のシリコンウェーハから作られます。

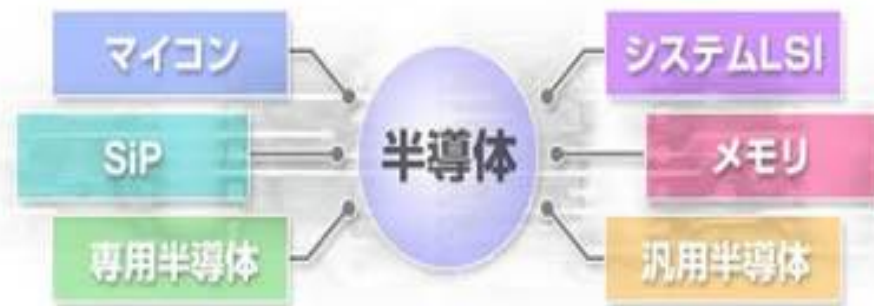
当社は**使用済みシリコンウェーハの再利用を目的として、精密加工を行う会社**です。



シリコンウェーハ再生事業-半導体の用途



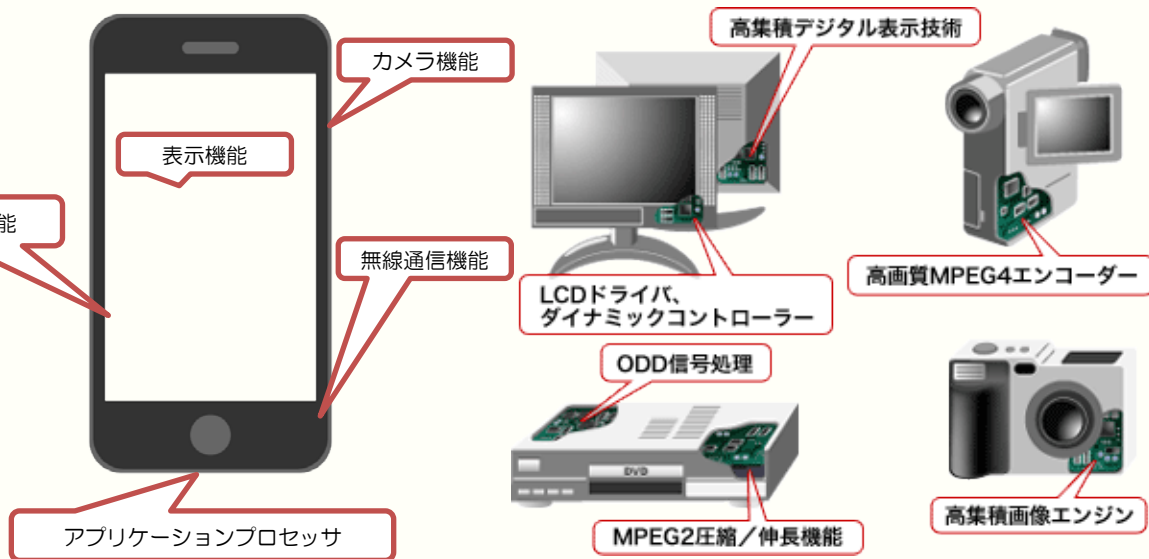
スマホ・タブレット
 ・ウェアラブル・自動運転
 ・家・ビル・町・IoT・・・etc



世界の半導体の需要は

- ★ 世界の人口増
- ★ 新興国の経済発展
- ★ 先進国の
デバイス用途の多様化

により拡大

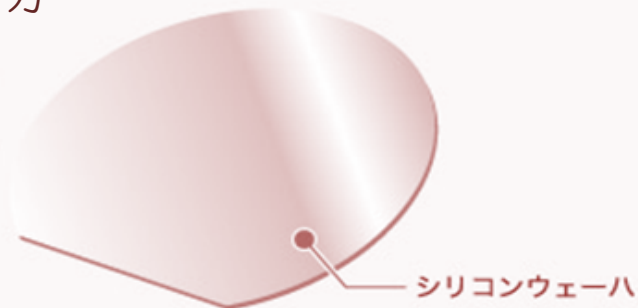


シリコンウェーハ再生事業-半導体製造概要

半導体製造のおおまかな流れ

ウェーハメーカー

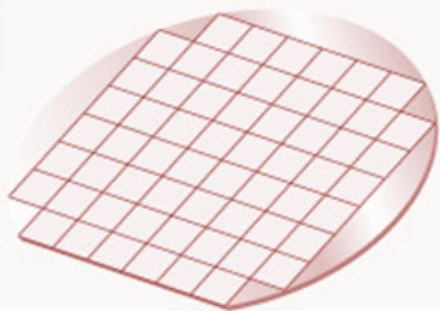
処理前



半導体メーカー

前工程

ICの回路を作る工程

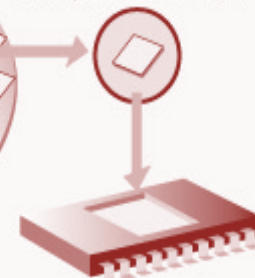


半導体メーカー

後工程

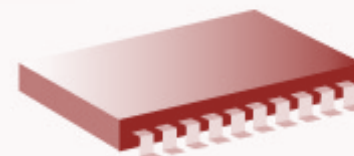
1個1個のICチップを
切り取り、パッケージ
に入れる工程

切り取ったICのチップ



ICのパッケージ

できあがり

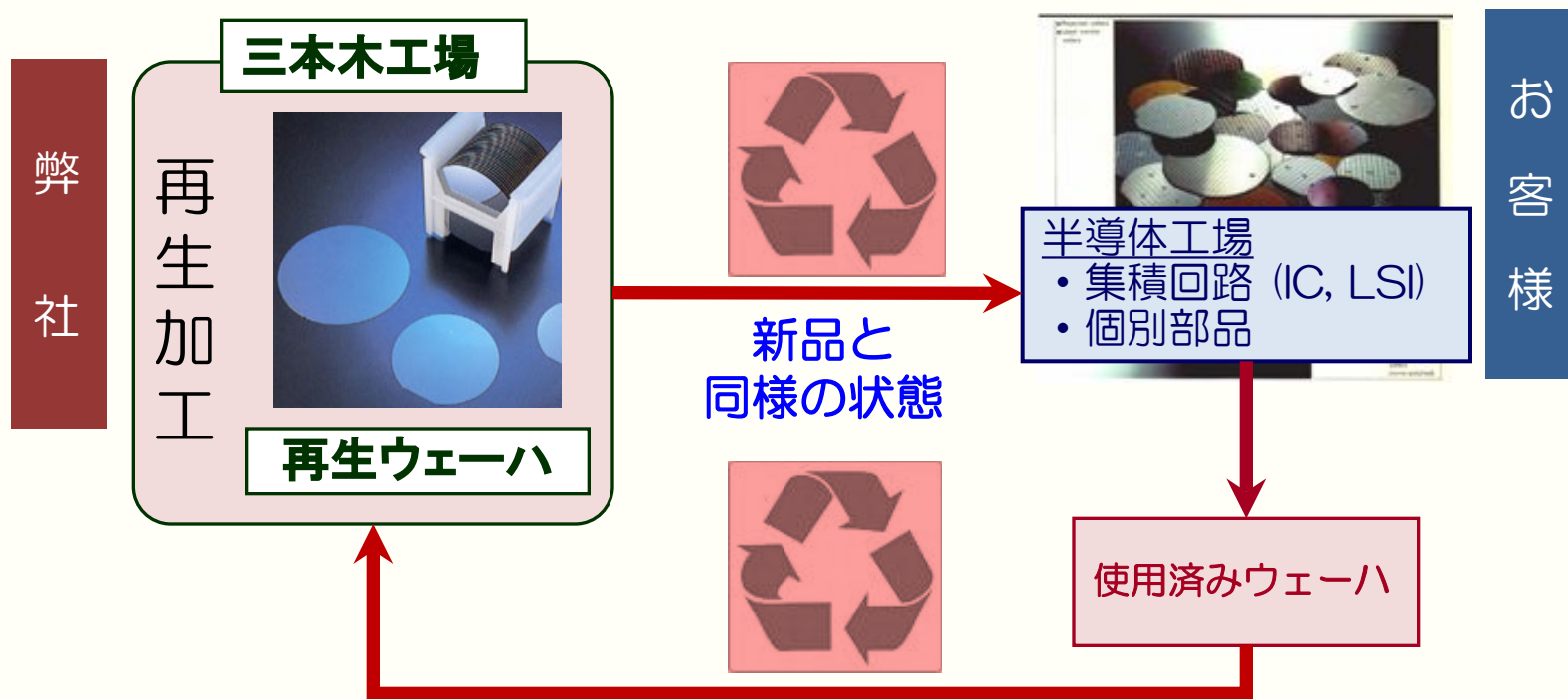


(3D) NAND・ファブドリーを中心に
当社の再生ウェーハが大量に使用されます。

シリコンウェーハ再生事業-再生とは？

半導体工場では700を超える工程がありますが、各工程のプロセス評価、出来栄えの評価のために『モニタウェーハ』が使用されます。これらのモニタウェーハは、1回～数回使用されると使用不可となりますが、弊社は、これらのウェーハをお預かりし、精密加工をすることで再利用が可能な新品と同様の状態に戻し、同じ用途で使用していただくサービスを提供しております。

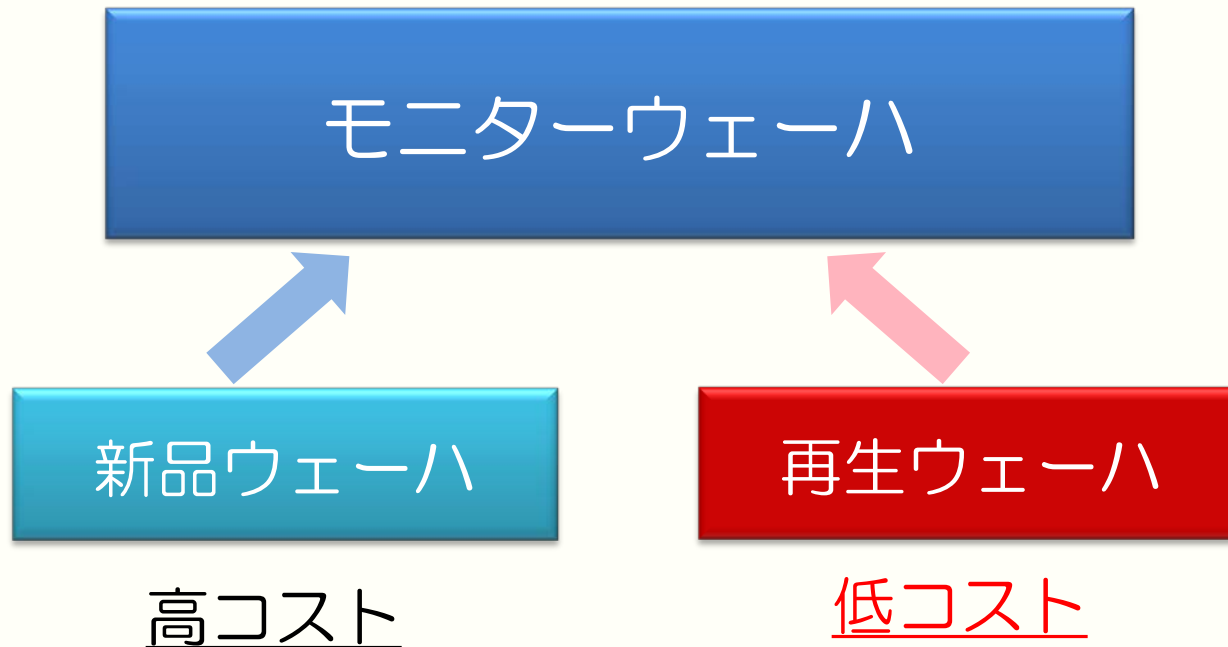
再生ウェーハはシリコンウェーハ全使用量に対し、20%強の需要があります。



シリコンウェーハ再生事業-なぜ再生が必要か？

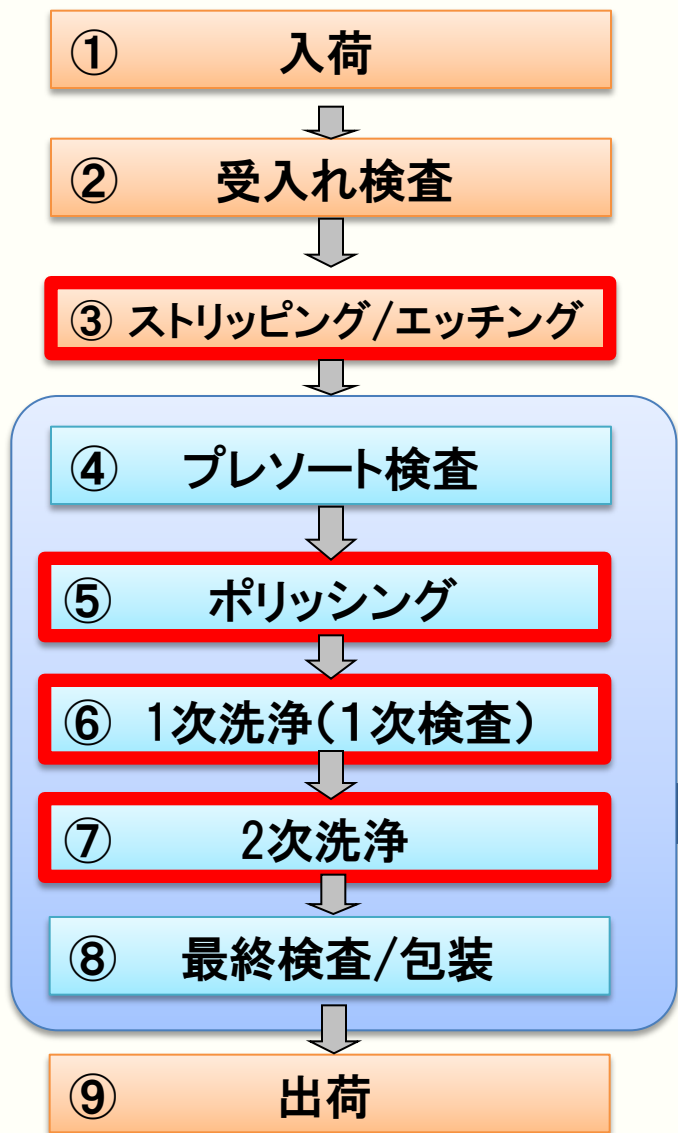
◇◇ なぜ再生ウェーハの需要があるのか？ ◇◇

◎一番の目的は、お客様の**コストダウン**のためです。



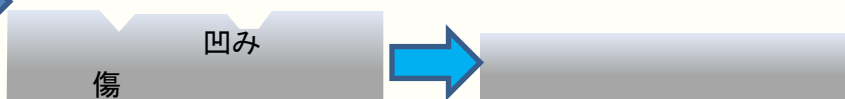
※環境負荷を減らすという目的もあります。

クリーンルーム

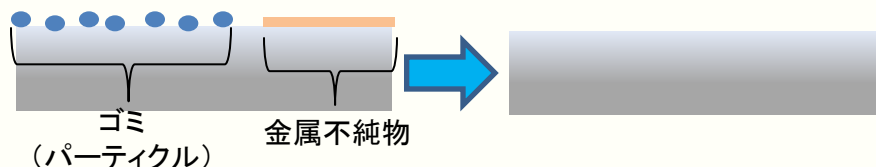


・強み①(すべての膜を剥離可能)
 ケミカルによる除去の為、表面のダメージが最小限に→「再生回数が多い」→よりコストダウンが可能に。
 ★ラサ工業(化学)の特異技術を承継

・表面に付いているキズや凹凸を研磨(ポリッシング)により平滑にする



・強み②(金属不純物を除去)
 ウェーハ表面の微細ゴミ、汚れ、を洗浄で取り除く
 + 金属不純物の除去
 特に銅 (Cu) の汚染除去に強み



Customer

Europe

Asia

Japan

USA

